

生益电子股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”或“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司结合发展阶段、行业特点、投资者建议等研究制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化公司核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：

一、聚焦印制线路板主业，持续优化产品布局

公司自 1985 年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，产品按照应用领域划分主要包括通信设备板、网络设备板、计算机/服务器板、汽车电子板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。作为电子产品生产制造的关键环节，公司通过不断提升技术水平和扩大产能，使产品质量和技术能力不断满足下游客户电子产品的需求与变化。

2024 年，公司将根据发展战略，以传统优势的通讯网络行业、长期深耕的服务器行业、快速发展的汽车电子行业为公司下游主攻方向，力求打造行业产品的全面覆盖，提升公司综合竞争力。

在通信市场领域，公司积极响应工信部关于持续巩固提升我国信息通讯业的竞争优势和领先地位，适度超前建设 5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让 5G 赋能千行百业；强化 5G 演进，支持 5G-A 发展；加大 6G 的研发力度的号召。公司紧密配合通讯设备商，持续提升技术能力，开发新产品，满足 5.5G 产品研发及量产的需求。

在计算机及服务器市场领域，公司积极响应信创的号召，全力支持客户，同时积极拓展生态链，与众多信创产业链的合作伙伴建立紧密的合作关系。公司在

AI 领域也取得了显著成果，成功开发了国内外部分 AI 相关 PCB 产品，产品涵盖 UBB 及 OAM 等高难度核心部件。数据中心及 AI 的发展加大了市场对数据传输设备的需求，公司积极研发 400G 及 800G 高速 PCB 产品，目前相关产品已经陆续批量交付市场，公司将进一步加大对 400G 及 800G 高速 PCB 产品的研发力度。同时，公司积极布局卫星通讯市场，与相关研究机构开展能力预研，努力把握下一代卫星互联网的发展机遇，为公司的长远发展奠定坚实基础。

在汽车电子领域，公司积极与国内外车企开展深度合作，参与新能源车企的逆变器项目、高压充电项目的开发及量产等。公司的智能中控产品成功打入高端品牌车企，2024 年力争进一步提升份额，进一步巩固公司在汽车电子领域的地位。

二、持续加强研发投入，保持技术领先优势

持续 30 多年的研发投入和技术积累，公司科技创新能力突出，在印制电路板领域已具有行业领先的技术水平，通过实践探索掌握了大尺寸印制电路制造技术、立体结构 PCB 制造技术、内置电容技术、散热技术、分级金手指制造技术、微通孔制造技术、微盲孔制造技术（HDI）、混压技术、微通孔局部绝缘技术、N+N 双面盲压技术、多层 PCB 图形 Z 向对准技术、高速信号损耗控制技术、高速高频覆铜板工艺加工技术、100G-400G 高速光模块印制电路板制作技术、内置导电介质热电一体式 PCB 制作技术等多项核心技术，使公司持续保持了较强的核心竞争力。

公司目前拥有 PCB 产品制造领域的完整技术体系和自主知识产权，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经获得了 243 项发明专利，制定了 16 项行业标准及规范。2023 年，公司持续加大对核心技术的深度研究和布局，新获得发明专利 14 项、新制定发布标准 5 项、新发表技术论文 15 篇，以持续提升的核心竞争力，维护公司在行业内的技术领先地位。

2024 年，公司将持续加强研发投入，将重点聚焦 224G 高速技术、新平台服务器及 AI 服务器、车载域控制器及 4D 雷达以及光模块高速高密等领域的相关技术研发，以保持公司技术领先的优势。主要项目详见下表：

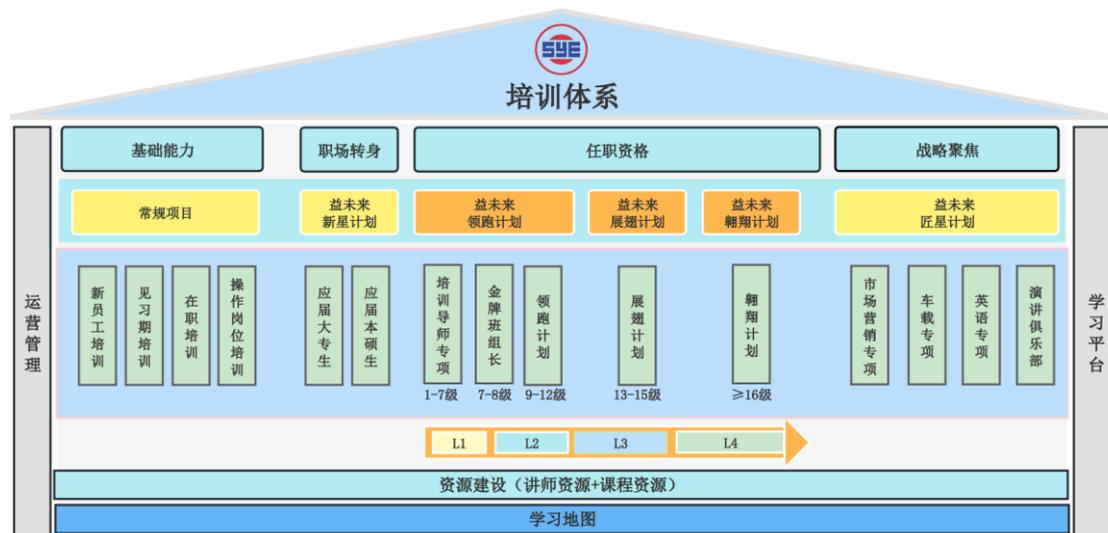
| 序号 | 项目名称 | 应用领域 | 项目研发目标 |
|----|--------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 高密组装高端印制电路板的技术研究开发 | 网络领域 服务器领域 | 研究开发双面阶梯图形（含阶梯金手指）、逐次压合 HDI 结构+阶梯槽图形等各种结构的三维组装，复杂结构的高端高密线卡板，提升公司在图形计算、高速网络服务器等高端线路板领域的竞争力，并实现产业化。 |
| 2 | 400G 及以上高端光模块印制电路板的研究开发 | 网络领域 服务器领域 | 研究开发面向电信光通讯网络及数据中心架构网络应用的 400G 及以上传输速率的高速光模块印制电路板产品，攻克高阶 HDI 复合客户光器件布件异形结构设计、精细 Wire Bonding 图形及金手指精密加工等技术难点，并实现产业化。 |
| 3 | 面向车载毫米波雷达的印制电路板的研究开发 | 汽车领域 | 研究开发面向车载毫米波雷达的印制电路板产品，提升公司在汽车智能驾驶领域的市场竞争力，并实现产业化。 |
| 4 | nR-nF-nR 特殊结构高多层软硬结合板工艺的研究开发 | 网络领域 服务器领域 消费电子领域 | 研究高阶 HDI 埋铜块、局部盖子保护、点胶、贴屏蔽膜、air-gap 等特殊结构高多层软硬结合板制作技术，攻克不对称结构翘曲、高多层软硬结合板可靠性等技术难关，并实现产业化。 |
| 5 | EGS 服务器高可靠性印制电路板的研究开发 | 服务器领域 | 研究开发高性能（损耗要求<0.96@16GHz）、低成本的材料应用于 EGS 平台产品的新技术，可靠性、BGA 平整度、翘曲等均能满足产品要求，提升公司在高端服务器领域的市场竞争力，并实现产业化。 |
| 6 | 面向智能驾驶汽车的信息传感及能源动力控制 PCB 的研究开发 | 汽车领域 | 研究不同材料 1500V 高压 CAF 的 PCB 制作工艺及失效模式潜在影响，完成面向智能驾驶汽车的信息传感及能源动力控制 PCB 产品的研制，并实现产业化，提升公司在车载高压平台 PCB 制作方面的市场竞争力。 |
| 7 | 面向能源产品的耐压超 4242V 的印制电路板的研究 | 新能源领域 | 研究开发面向能源产品的耐压超 4242V 的印制电路板产品，提升公司在光伏新能源领域的市场竞争力，并实现产业化。 |
| 8 | 高密精细线路高阶互联印制电路板的研究开发 | 消费电子领域 汽车领域 | 实现 anylayer HDI 高密互联产品结构设计的制作，具备各层 0.35mm pitch BGA 夹横竖绕线的精细线路制作能力，提升我司在消费类产品及可穿戴等产品上竞争优势，并实现产业化。 |

三、深化组织运营管理，提升综合竞争力

1、强化优秀人才培养建设，激发组织活力

公司一直把人力资源作为公司的第一资源，重视员工发展及成长。基于外部经济形势、行业竞争以及公司开拓市场、海外布局，2024 年人力资源管理将继续

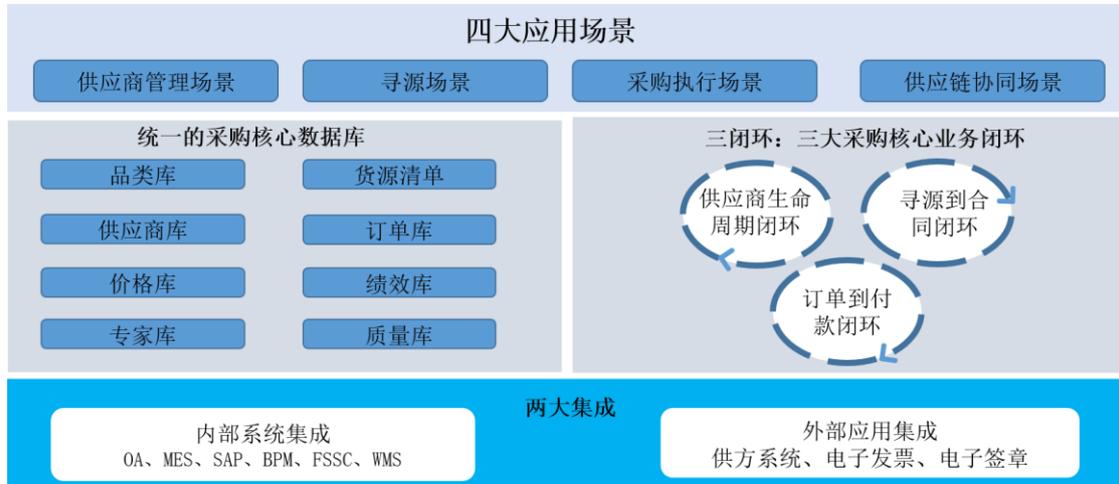
深入推进人效提升，在此基础上优化公司薪酬结构及激励机制，提高员工的工作动力、满意度和绩效；通过强绩效管理引导员工发挥自身价值、创造价值，公司与员工分享价值，提升员工获得感。同时，公司将持续完善培训与发展体系，重视后备人才的培养和发展，通过领跑计划、展翅计划助力各层级管理者实现管理能力升级。基于公司战略发展需要，2024 年重点开展匠星计划，如市场营销专项、车载专项、英语专项等，持续提升员工专业能力，助力业务成功。



2、建立充分竞争的商务环境，保证采购安全和推动成本节省

公司持续完善供应链管理体系，搭建了 SRM 供应商管理系统，打造客观、公正、阳光、多元化的采购体系。通过建立敏捷、柔性、高效协同的供应链管理体系，实现信息流、物流、资金流、业务流和价值流的有效集成和控制。2023 年，公司在全球合作供应商近 700 家，其中超过 95%来自国内，关键物料认可多家供应商，确保供应安全。2024 年，公司将加强与核心供应商的战略合作关系，计划开展超过 100 次的培训及技术交流，计划开展超 50 次的供应商现场审核，计划导入超 20 项的新物料，进一步保障供应链安全，建立充分竞争的环境，为降本增效保驾护航。

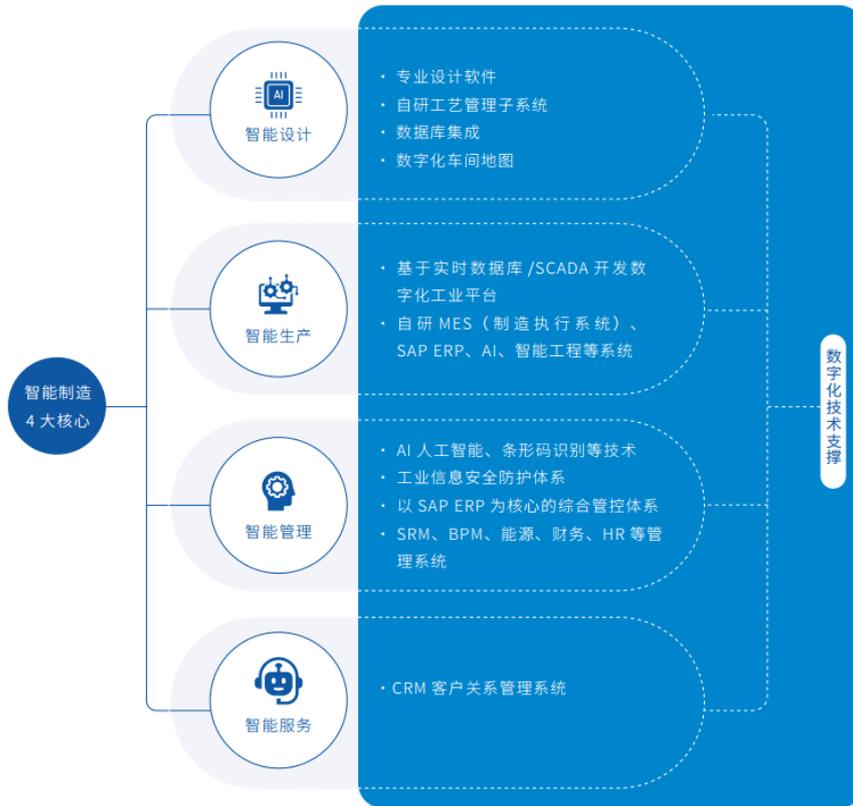
持续优化供应链协作平台 (SRM)，把物流、信息流、资金流、业务流和价值流的管理贯穿于供应链的全过程。



3、提升自动化和智能化水平，提高生产效率

在先进制造技术的融合催化下，制造业的设计、生产、管理、服务各环节正逐步走向智能化。公司把握数字技术发展机遇，借助数字化转型的力量，融合 5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，以数智驱动企业转型升级，全面提升产品创新与管理能力，从而在提高质量、提升效率方面取得优势。通过人、机器、技术的革新，不断推动业务变革与流程优化，实现数字化智能工厂的落地。

2024 年，公司围绕“聚焦重点、提升效能”的策略，持续推行和完善数字化建设，包括但不限于：依托数据仓库和 BI 平台持续建设数据中台，重点实施 PCS 级产品追溯项目，为质量数字化管理提供强有力的分析平台。持续推广全自动智能排产平台（新一代 APS），实现东城三厂全部核心流程上线，并推广到其它工厂，提升制造自动化和智能化。实施大数据 AI 预测项目，并密切关注大模型 AI 的发展，为企业内部用户赋能、提供生成式 AI 在工作中的应用。实施 RPA 机器人流程自动化项目，至少上线 20 个流程。通过数字化推动工作质量和效率的持续提升。



4、进一步强化质量管理，保证公司产品质量竞争力

强化“零缺陷”管理，持续优化并推进零次废员工管理评审，树立员工一次做对的理念。同时各工厂全员推进 QCC 小组活动开展，推动全工序零缺陷有效落地，提升工厂整体质量管理水平。

推进质量管理机制落地，质量中心定期组织质量会及质量案例交流，梳理改善重点，评估改善效果。每年年底与年初组织质量规划研讨与发布，明确公司整体的质量重点工作与方向，有效指引各工厂开展相应的质量改善活动。同时，公司将持续推行举手机制、质量红线机制以及质量管理闭环监督机制的有效落地，组织工厂质量一致性的对标与提升，不断优化质量激励规范，推动全员参与质量改善，提升质量意识，促进质量效益提升。

推进质量改善专项与质量平台建设，主要在严进、过程管控、严出、客户服务等方面加强管理。严进方面，将持续优化来料检验方法与标准，提升检验手段，利用管理 IT 化不断推动供方质量提升与内部质量稳定。过程管控方面，持续推动工厂 PCS 级追溯管理平台以及质量自主预警平台的搭建与推广应用；梳理工厂主要业务流程与优化，提升工作质量与效率。在严出方面，重点推动各工厂质量

检验有效性提升，建立质量检验地图。在客户服务质量方面，提升服务人员的专业能力与水平，及时响应客户需求，提升客户满意度。

四、聚焦公司重大项目，有力有序推进项目实施

为持续提高公司产能规模和核心竞争力，公司近年来有序开展和实施重大项目，如吉安生益一期项目、东城四期项目等。2024年，公司将会持续加强重大项目管理，深化项目策划、项目实施、项目评价，严谨论证项目可行性方案，有力有序推进项目实施，系统评价项目效果，以促进公司主营业务的持续发展，增强公司整体的盈利能力。

1、有力推进东城四期项目，有序扩大产能规模

东城四期项目是公司实现产品和技术升级的重要举措，尽管受到行业景气波动的影响，整体项目仍按照计划有序推进，新工厂经过2022年底试产，2023年3月份开始上量，逐步导入目标产品，通过攻克工艺难题稳定过程质量，2023年月产量已阶段性达标，并达到盈亏平衡点。2024年，公司将持续推动东城四期项目提产以及目标产品的导入，进一步提升高阶高密HDI产能和软硬结合板产能，提升项目盈利能力。



2、稳步推进吉安二期项目，结合市场环境扩充汽车 PCB 产线

吉安二期项目定位中高端汽车电子产品，以全面扩充公司在汽车电子产品方面的产能，进一步增强汽车领域的竞争力。项目于2022年8月份启动厂房建设，2023年9月份完成厂房封顶，截至目前，工艺及公共设施规划基本完成。根据公司募集资金投资项目实际建设情况，结合市场形势、产能规模及实际建设需要，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。2024年，公司将围绕项

目定位和项目计划推进项目实施，同时，公司将高度关注市场变化情况，如市场环境一旦变化，将随即响应并快速扩充产能，以抓住市场机遇，实现公司规模的稳健扩张。



3、系统布局泰国新建生产基地项目，推动项目启动建设

为深化实施海外战略布局，进一步开拓海外市场，建立产品海外供应能力，更好的满足国际客户的订单需求，公司决策在在泰国投资建设生产基地。泰国作为新兴市场经济体，具备土地、厂房、人力、税收等方面的成本比较优势，近年来亦承接了较多的印制电路板产能转移，印制电路板相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满足公司建设海外生产基地的需要。2023年，公司在董事会的授权下，完成泰国公司设立、境外投资备案、签署土地购买协议、转移土地权等。

2024年，公司将围绕海外战略、行业发展、客户需求等进一步完善公司在泰国新建生产基地的具体安排，尽快推进落实在泰国投资新建生产基地的生产规模。

五、持续完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体方案如下：

1、深入贯彻落实独立董事制度改革

公司将加快落实独立董事制度改革，修订《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作细则》等相关制度，并严格按照相关制度要求执行。公司已为独立董事们开设专属办公室，便于独立董事开展每年不少于 15 日的现场工作，并指定了董事会办公室作为沟通服务机构，专门负责组织交流、会议议案材料编制、信息反馈等工作。公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，

并提交相关文件，为独立董事工作提供便利条件，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

2、持续深化内部审计工作

公司已建立较为健全的内部控制制度体系，公司内部岗位职责明确，权限和业务流程清晰，并将内部控制权限设置及流程要求融入到信息系统中，实现防呆防错，确保内部控制要求的有效落实。公司审计部及第三方审计机构对内部控制运行有效性进行定期监督评价，评价结果显示，内部控制实际运作情况符合中国证监会及有关部门发布的有关上市公司治理规范的要求，能够有效防范业务运行过程中的重大风险。

2024年，按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《公司内部审计制度》《公司董事会审计委员会议事规则》的要求，为了更好的实现内部审计目标，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经营效益中的作用，公司内部审计部将公司的战略目标、经营目标及重大项目相结合，重点关注生产循环、销售业务、研究与开发业务、采购业务、人力资源管理等核心业务领域，以内部控制审计为基础，经营审计、任中审计为核心，以保证各职能部门有效发挥应有的功能，促进组织的有效运营和实现目标。

3、持续强化管理层约束

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

六、加强投资者沟通交流，完善投资者意见征询与反馈

公司董事会办公室为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司积极接听投资者专线，及时回复“上证E互动”平台以及投资者交流邮箱上投资者关注的问题，在年度报告、半年度报告、季度报告披露后，在“上证路演中心”、“全景网”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读，并在“上证路演中心”以图文简报的形式对财务报告进行可视化展示，在“生益电子”公众号上发布一图读懂年报、一图读懂社会责任报告，在生益电子官网设置投资者关系专栏，并下设股东回报、最新公告、财务数据、公司研报、公司调研五个专项，方便投资者以各种渠道了解公司。公司严格遵循法律法

规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。具体包括以下方面：

1、加强投资者线上交流活动

未来，公司将继续保持与投资者积极的线上交流，每年通过“上证路演中心”等平台举办不少于4次投资者线上交流会。

2、丰富投资者接待形式

未来，公司将持续丰富投资者接待形式，如结合投资者意愿接待投资者现场调研，业绩说明会采用视频+文字互动形式开展，让投资者更深入的了解公司。

3、完善投资者意见征询及反馈机制

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

七、完善投资回报机制，启动实施股份回购

公司结合自身情况完善投资者回报机制，重点聚焦股份回购计划和现金分红计划，主要如下：

1、股份回购计划

基于对公司未来发展前景的信心、公司长期投资价值的认可及切实履行企业的社会责任，为完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

2、现金分红计划

公司坚持稳健、可持续的分红策略，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。2021年度、2022年度，以公司股份总数831,821,175.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），每年派发股利133,091,388元。分别占2021年度、2022年度归属于上市公司股东净利润的50.36%、42.53%。

2024年3月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。鉴于公司2023年度未实现盈利，充分

考虑到 2023 年度经营情况及 2024 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

未来，公司将按照《公司章程》的相关规定，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

八、强化管理层与股东利益的共担共享约束以及“关键少数”的责任

1、强化高级管理人员激励及约束

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，根据《生益电子股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合公司的发展阶段，制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。围绕《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司中期发展战略、2024 年重点工作以及行业情况等制定高级管理人员 2024 年绩效考核指标，以充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展。

高级管理人员 2024 年绩效考核设置了资产收益率、销售收入、核心客户开发进度完成率、技术创新、成本、人效等指标。上述考核要求锚定公司经营状况、成长性、盈利能力等与投资者利益紧密相关的指标，并设定了具有一定挑战性的考核目标，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。

2、控股股东自愿延期解禁

公司于 2023 年 10 月 16 日收到公司控股股东广东生益科技股份有限公司关于自愿延期解禁限售股的说明。控股股东认为，公司主营业务为印制电路板的研发、生产与销售，公司的主要客户是通信设备、网络设备、计算机/服务器、汽车电子、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等行业优质客户。作为电子产品生产制造的关键环节，公司通过不断提升技术水平和扩大产能，使产品质量和技术能力不断满足下游客户电子产品的需求与变化。公司在建项目多且进展良好，未来几年将陆续投产，新项目投产后，行业地位将明显提升，行业影响力将明显增强。基于对公司价值的认可和未来发展的信心，控股股东决定延期解禁所持全

部限售股 6 个月，延期后解除限售日期为 2024 年 8 月 24 日。

3、部分股东自愿承诺未来六个月不减持公司

公司于 2023 年 10 月 16 日收到公司股东东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司关于自愿承诺未来六个月不减持公司股份的说明。公司股东东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，上述股东自愿承诺，自承诺函签署之日起 6 月内（2023 年 10 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日）不减持其所持有的公司股份

4、5%以上股东国弘投资增持公司股份

公司于 2023 年 10 月 27 日收到公司持股 5%以上股东东莞市国弘投资有限公司的告知函，东莞市国弘投资有限公司拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，通过上海证券交易所允许的方式，增持本公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元，资金来源为国弘投资自有资金和自筹资金。

九、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注印制电路板主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

生益电子股份有限公司

2024 年 3 月 28 日